PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2002-299405

(43)Date of publication of application: 11.10.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/68 B08B 13/00 B25J 15/08 B65G 49/07 H01L 21/304

(21)Application number : 2001-095538 (22)Date of filing:

29.03.2001

(71)Applicant : DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

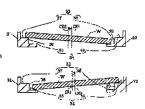
(72)Inventor: KAMIYAMA TSUTOMU ADACHI HIDEKI FURUMURA TOMOYUKI

(54) SUBSTRATE TRANSPORTING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate transporting apparatus which prevents the recontamination of cleaned substrates and allows a plurality of substrates to be exchanged in a comparatively simple constitution.

SOLUTION: A main transport robot for transporting a substrate W to a processor has a first and second holders 33, 34 formed on the upside of a support arm forming a hand. The first holder 33 is for transporting an uncleaned substrate W before a cleaning step and the second holder 34 is used only for transporting the substrate W after the cleaning step. The first and second holders 33, 34 are composed of a plurality of support faces for holding the substrates of the same size and hold the substrates W included so as to mutually overlap part of their substrate W holding spaces.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-299405 (P2002-299405A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002, 10, 11)

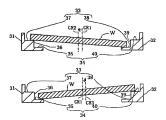
				(10) 1400 13	1 //// 1		
(51) Int.Cl. ⁷		鱵別記号	FΙ			Ŧ	-73-1*(参考)
H01L	21/68		HOIL	21/68		Α	3B116
B08B	13/00		B08B	13/00			3 C 0 0 7
B 2 5 J	15/08		B 2 5 J	15/08		Z	5 F 0 3 1
B 6 5 G	49/06		B65G	49/06		Z	
	49/07			49/07		E	
		審查請求	未請求 請求	R項の数3 C	DL (全 g	E ()	最終頁に続く
(21)出願番号		特順2001-95538(P2001-95538)	(71)出職人 000207551 大日本スクリーン製造株式会社				
(22)出順日		平成13年3月29日(2001.3,29)	京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁 目天神北町1番地の1				
			(72)発明:	(72)発明者 上山 勉 京都市上京区場川通寺之内上る4丁目天神			
						3本ス	クリーン製造株
			(200) 200 200	式会社内			
			(72)発明:				
							上る4丁目天神
				北町1番地 式会社内		3本ス	クリーン製造株

(54) 【発明の名称】 基板搬送装置

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】洗浄済み基板の再汚染を防止するとともに、比 較的簡単な構成で複数の基板の交換に対応できるように した搬送装置を提供すること。

【解決手段】基板Wを処理部に対して撤送するための主 搬送ロボットは、ハンドを構成する支持腕の上面側に第 一の保持部33は洗浄処理前の未洗浄基板Wの搬入を行 い、第二の保持部33は洗浄処理前の未洗浄基板Wの搬入を行 い、第二の保持部33は洗浄処理域の基板Wの搬送にの が使用される。第一の保持部33と第二の保持部34 は、サイズの同じ基板を保持するための複数の支持面か ら構成され、且いに基板Wの保持空間の一部が重なるよ うに基板Wを解的させて保持する。



最終質に続く

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アームを有し、このアームの先端部に設けられたハンドによって基板を搬送する基板搬送装置において、

前記ハンドには、異なる基板を保持するための複数の保 持部がハンドの同面側に形成されていることを特徴とす る基板搬送装置。

【請求項2】 請求項1に記載の基板搬送装置において、

前記ハンドには、サイズが同じ基板を保持するための保 10 持部が形成されていることを特徴とする基板搬送装置。 【請求項3】 請求項2に記載の基板搬送装置におい

前記保持部は、基板の直径方向の両端縁を支持すると共 に、ハンドの一面からの突出位置が異なる一対の支持面 を有1

第一の保持部は、第二の保持部の一方の支持面をまたい で一対の支持面が配置され、

第二の保持部は、他方の支持面が第一の保持部の一方の 支持面をまたいで配置され、

第一と第二の保持部による基板保持空間が重なることを 特徴とする基板搬送装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体ウエハ、液 品表示装膜門ガラス基板およびPDP (プラズマ・ディ スプレイ・パメル) 用ガラス基板などの各角の触型建基 板 (以下、単に基板と称する)を、これらの基板に対し て各種の処理を施すための処理部に対して厳密するため の基板搬送機能に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置や液晶表示装置を製造する場合、基板に積々の加工を繰り返して行わなければならない。たとえば、上記基板に回路パターンを形成する工程では、成膜プロセスやフォトプロセスなどがある。これらのプロセスでは上記基板の処理と洗浄とが繰り返して行われる。たとえば、基板に露光処理を行ったなら、この基板をエッチング処理し、ついでその基板からレジストを測離するアッシング処理を行う。つぎに、アッシング処理された基板を洗浄処理してから乾燥処理するとい 40

[0003]上述した各種の処理工程において、基板を それぞれの処理部に受け渡すための搬送装置には、たと えばスカラー型のロボット装置が用いられている。搬送 装置は周辺のように本体を有し、この本体には回転駆動 される駆撃動体設けられている。この駆動地の地端には 1つあるいは複数のアームが連結されている。アームの 先端にはハンドが設けられ、このハンドには上記基板を 保持するための供持部が設けられている。

【0004】上記駆動軸が回転駆動されると、この回転 50

に複数のデームとハンドとが連動し、先端のハンドが前 進あるいは後進方向に駆動される。それによって、ハン ドの保持師に保持された基接を受け渡すことができるよ うになっている。基板を1枚ずつ処理するための枚葉式 基板処理整膜においては、この一対のアームが処理部に 対して独立して進退可能に構成されている。

【0005】一方、基板に対して能される重要を処理のつた、基板の表面の不要な限やバーティクルを除去するための洗浄処理がある。したかって、基板処理域置には、基板を洗浄するための洗浄処理部が備えられる場合がある。ところが、上記のようを一対のアームによる散出入においては、いずれのアームが各処理部での処理前の基板および処理を返しました。となかは不でであるから、洗浄処理師の基板を保持している。この場合には、洗浄処理を経り入野・アームによって、洗浄処理を必様の機出が行われる場合がある。この場合には、洗浄処理物の基板があるがである。この場合には、洗浄処理物の基板がある。この場合には、洗浄処理物の基板がある。この場合に、洗浄処理物の基板がある。

【0006】そこで、未処理基核による悪影響を処理済 基板に与えないで、処理部への縁板離入および処理部か の基板離仏を好に行うことを目的として、例えば特 開平7-297256号公報に開示されたものが場案さ れている。特開平7-297256号公報には、一対の 支持手段と、一対の支持手段の側隔を変更する間線変更 手段の間隔の変更に対応して洗浄剤の最板の周線を支持 する第1支持能と洗浄部の基板の周線を支持 方路の上が海が成立れる基板兼送板置が記載されている。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような構成を有する従来例の場合には、次のように改善の 亦能がある。かかる基板施送数では、支持手段の間隔 の変更に対応して、洗浄前の基板は第1支持部により支 持され、洗浄後の基板は第2支持部により支持されることで、基板の特及が抑制されるものであった。しかしな がら、間隔変更手段として駆動能を構成する必要があ り、構造が複雑になるととともに搬送装置全体の重量が 重くなる。そのため、装置のコンパクト化の妨げとなった。

【0008】また、洗浄前の基極を支持していた状態から、洗浄後の基極を支持する状態に一対の支持手段の川 服を変更する必要がある。そのため、基板の端縁を保持 する上で、間隔の変更を十分な位置精度をもって行える ように構成する必要があった。または、支持手段の基板 繊縁を支持する都位を余裕をもった大きさに形成する必 要があり、装置のコンパタト化に関連点があった。

【0009】本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、上述の技術的課題を解決し、洗浄処理が施された後の洗浄済み基板の再汚染

を防止することができるとともに、コンパクトな基板搬 送装置を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段およびその作用・効果】上 記目的を達成するために、本発明は、アームを有し、こ のアームの先端部に設けられたハンドによって基板を撤 送する基板搬送装置において、前記ハンドには、異なる 基板を保持するための複数の保持部がハンドの同面側に 形成されていることを特徴とする基板搬送機型である。

【0011】請求項2に係る発明は、請求項1に記載の 10 基板搬送装置において、前記ハンドには、サイズが同じ 基板を保持するための保持部が形成されていることを特 徴とする。

[0012] 請求項3に係る分割は、請求項2に記載の 基板便遊装置において、前記保持部は、基板の直径方向 の両端縁を支持すると共に、ハンドの一面からの突出位 設が異なる一対の支持面を有し、第一の保持部は、第二 の保持部の一方の支持面をまたいで一対の支持部が利置 され、第二の保持部は、他方の支持面が第一の保持部の 一方の支持面をまたいで配置され、第一と第二の保持部 による基板保持空間が重なることを特徴とき。

【0013】未発明の作用は次のとおりである。請求項 1に係る労研の基礎送該費においては、ハンドに形成 第1の保持郎で未洗浄基板を保持される、例えば、 第1の保持郎で未洗浄基板を保持さまた。第2の保持 高で洗浄済み基板を保持する。したがって、未洗浄基板 を保持した履服を持つ保持部からのパーティクルが洗浄 済み基板に転移するおそれがないから、洗浄済み基板の 市汚災を防止できる。また、保护部はハンドの高・前 形成されているので、装置がコンパクトになる。さら に、予め貴なる基板を保持するように形成されるので、 転板保持値即の混窓のための構成付加が急吸ない。

○毎本以前では回じりれるとしたのとか呼吸いれかがなどから (日の14) 新東京県 に係る時間によれば、役替部は同 じサイズの基板を保持するように形成されているので、 何人は気が几つ板を行う処理師に、抵板を搬入して、処理所 みの基板を搬出して別の処理部に搬入する場合に、この 処理部にまする基板の搬入および搬出を一つのハンドで 相欠いで行うことができる。

[0015] 譲東項3に係る発明によれば、第一の保持 師では第二の保持師の一方の支持面をまたいで基板が保 40 持される。また、第二の保持部では第一の保持部の一方 の支持面をまたいで基格が保持される。すなわち、第一 と第二の保持部による基板保持空間が重なっており、小 型なハンドが提供される。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の一 実施例を説明する。

<基板処理装置の構成>図1は、この発明の基板搬送装置が設けられる基板処理装置のレイアウトを示す簡略化した平面図である。

【0017】この基板処理製度は、基板Wを力セットC から1枚ずつ取り出し、この基板Wに対して第1の楽液 処理、第2の業能処理および水洗・乾燥処理を順に施す ことにより、築液によるエッチング効果を利用して基板 の発浄を行り枚遅式洗浄装置である。第1および第2 の薬液処理は、たとえば、フッ酸やアンモニア水などの 築液を用いて基板Wの表面を洗浄するための処理であ り、第1の素液処理を第2の無機処理をでは及れる条液 が用いられる。また、水洗・乾燥処理は、薬液処理後の 基板Wを軽水によりリンスし、さらに、高速に回転させ て水りめ燃発を行うための処理である。

【0019】処理部Pは、インデクサ部INDの直線数 送路3の中間付近において、この直線数送路13とに立て る方向に沿って配置された直線般送路13と、この直線 搬送路13に沿って定行する主線送区ボットMTRとを 備えている。なお、主線送路13の両側には、第1処理トラ ック11と第2処理トラック112とが短り分けられてい る。第1処理トラック112は、近期2月トラック12 は、それぞれ、上記別1の薬液処理と上記第2の薬液処 理と上記水洗、乾燥処理を一つの処理部で連続的に行う 処理部MTC1~MTC4を複数有しており、これらの 複数の処理部MTC1~MTC4は、直線機送路13に 粉つて2億分で配列されている。

【0020】第1処理トラック11および第2処理トラック12の処理部外TC1〜MTC4に対する基板Wの 搬入および舞出出、主触送ロボットMTRによって行われる。主搬送ロボットMTRは、未処理の基板Wをインデクサロボットとから受け取って第1の処理部MTC1に搬入し、第1の処理部MTC1での処理が終了した後の基板Wをインデクサロボット2に受け渡す。同様に、未処理の基板Wをインデクサロボット2に受け渡す。同様に、未処理の基板Wを2つ処理部MTC2に搬入し、この第2の処理部MTC2での処理が終了した後の基板Wを機出して、インデクサロボット2に受け渡す。

【0021】 <基板搬送装置の構成>図2は、主搬送口

ボットMTRの構成例を示す簡略化した斜視例である。 主搬送コボットMTRは、低線搬送路13に配置された レール21上に沿って移動信をに設けられた船台22 と、この基台22に対して興降および到値輸出わりの回 動が自住に設けられた昇降・回転台23と、この列降・ 回転台23に、進退自作に設けられた1本の基を保持ア ームHんを備えている。なお、主搬送ロボットMTR が本発卵の系体搬送装置に出げする。

【0022】 基合22には、レール21に沿って図外に 配置されたねし軸に螺合するボールナットが設けられて おり、ねむ軸には、正逆回底が可能なモータからの回転 が与えられるようになっている。このように、ねじ軸á よびモークなどにより、基合22をレールに沿って往復 直線移動させるためのボールねじ機構が開設されてい る。また、基合22に対する昇降・回転台23の昇降 は、図外のボールねじ機構により行われるようになって いる。

【0023】図3は主機送ボットMTRの平面図、図4は側面図であって、この主機送ボットMTRの基板保持アームIII んは、昇降・回転台23上面に第1のアーム2 205の一機が建轄されている。この第1のアーム25の他端には第2のアーム26の一般派には第27が設けられ、この取付け部材27が設けられ、この取付け部材27が設けられ、この取付け部材27が設けられ、この取付け部材27にはハンド28が葡萄可能に取付けられている。

【0024】上記第1のアーム25、第2のアーム26 及び取付け部料27の連結部分には図示しないブーリが 設けられていて、これらのブーリには同じく優示しない ベルトが製設されている。そして、これら第1のアーム 25、第2のアーム26及び取付け部料27は上記昇降 ・回転台23の回転に連動するようようになっている。 すなわち、上記別降・回転台23が回転駆動されると、 屈曲状態にある第1のアーム25と第2のアーム26と が所定方向に伸長するようになっている。なお、アーム 25、26の伸長方向は、昇降・回転台23を回転させ ることで変えることができる。また、昇降・回転台23 を上下方向に駆動することでアーム25、26の高さ位 置を測修できるようになっている。

[00025] ハンド28は、基板Wを支持する1組の支持腕31、32を有している。支持腕31、32は、基 40 板Wを支持しる姿勢で、近いた対向して配置されている。更に詳細には、図5及び図66を参照して説明する。図5は、支持腕31、32の関係の形状を示す平面図、図6(a)および(b)は、図5のAA—AA級で切断した部部部面図である。図6(a)は、支持腕31、32が洗浄剤の基板Wを支持した状態を、図6(b)は、支持腕31、32が洗浄剤の基板Wを支持した状態を、それぞれ示す。

【0026】支持腕31、32は、それぞれが樹脂にて 板状に形成され、その上面に互いに対向する辺におい て、搬送される基板Wの周輪を保持するための第一の保 持部33と第二の保持部34が、支持腕31、32と一 体的に形成されている。第一の保持部33と第二の保持 部34は、支持腕31、32にそれぞれ基板Wの縁部に 拾うように円弧形状に形成されたテーバー状の平川な粒 数の支持衛を組み合せて棚底されている。

【0027】 支持腕31は、上面に低、形成された第一 支持而35の端縁に、基板W外間縁の形状と同一の円弧 を描く立ち上がり壁36が形成され、その立ち上がり壁 36の上端に連なって第二支持而37が形成されてい る。そして、支持腕32は、上面に低く形成された第一 支持而38の端縁に、基体W外間縁の形状と同一の円弧 を描く立ち上がり壁39が形成され、その立ち上がり壁 39の上端に連なって第二支持面40が形成されてい る。

[0028] このような構成のハンド28によれば、第 一の保持部33は、支持腕31の第二支持両37と支持 腕32の第一支持両38の対で構成される。そして、た とえば直径が200mmの半導体ウエハ等の基板W(図 6(a)に断面で示す)を傾斜した姿勢で保持できるよ うになっている。

【0029】第二の保持部34は、支持腕31の第一支 持面35と支持腕32の第二支持面40の対で構成され る。そして、同じく、直径が200mmの基板W(図6 (b) に断面で示す)を傾斜した姿勢で保持できるよう になっている。

【0030】つまり、第一の保持部33と第二の保持部334、以第 (4)に示すように基板Wを保持する際に、第一の保持部33は、支持腕31の第一支持面35 を基板Wがまたぐように、第一支持面35より外側で上方に位置する第二支持面37と、支持腕32の第一支持面38とを一対として構成する。支持腕31の第一支持面35は、第二の保持部34を構成する一方の支持而として機能するが、基板Wはこの第一支持面35には当接することはない。

【0032】また、立ち上がり壁36、39は、第一および第二の保持部33、34に支持された基板Wの端縁の左右への位置を規制して、基板Wの位置決めを行う。

【0033】なお、この第一および第二の保持部33、 34は段部からなるので、ハンド28に一体形成して形 成されることを容易となす。また、段部を別部材で形成 し接着するようにしてもよい。

【0034】また、2個の保持部33、34のうち、一方の第一の保持部33は、第1ないし第4の処理部MTC1~MTC4に対する基板Wの搬入のために用いられる未洗浄処理基板搬送アームの保持部として設定される。

【0035】他方の第二の保持部34は、洗浄処理が完 10 了した後の基板の搬出にのみ用いられる洗浄処理済み基 板用アームとして設定される。すなわち、第二の保持部 34は、水洗・乾燥処理後の基板Wを搬出して、インデ ウサロボットとに受け渡す数型のある。

【0036】次に、処理フローの一例を示せば次のとおりである。図1に戻って、まず、カセットCに収納されている基板収を受け収る際には、インデグサロボット2を撤送路3に沿う矢印IUで示すソ方向に一体的に移動することができる。そして、ソ方向に移動して目的のあせットCの前まで移動し、さらにX方向に移動して、目的の基板Wの高さまで昇降し、さらにX方向に移動して、目的の基板Wの下方においてカセットC内に入り込むことができる。その後、ハンドをZ方向に上見させることによって、基板Wをハンドに保持することができる。そして、ハンドをX方向に沿ってカセットCから後退させる。

に移動して基板受け渡し位置において、主搬送ロボット MTRが基板保持アームHAで基板Wを受け取り、この 主搬送ロボットMTRは、基板保持アームHAのハンド 28の第一の保持部33にその基板Wを保持した状態 で、第1の処理帳MTC!まで走行する。

【0038】この時、主搬送ロボットMTRは、図6 (a) に示すように、基板の中心級CR2かハンド28 の支持腕31、32の中心級CR1よりも毎中左側に変 位して城板Wを保持する。こうすることで、基板収は、 第一の保持部33を構成する。と前で支持面35に第一支持 面38に脱落することなく確実に保持される。この設定 は、基合22の移動位間を制御することで、基板保持ア 一ム日Aの基板Wに対するの間が制御される。

[0039] そして、基板保持アームHAを第1の処理 40 那MTC1に対向させた状態で、ハンド28を第1の処 理部MTC1に進入させ、そして、ハンド28の第一の 保持部33から第1の処理部MTC1への基板Wの受け 渡しが完了すると、ハンド28が第1の処理部MTC1 から退出させられる。こうして、第1の処理部MTC1 における処理対象の基板が変われる。

【0040】第1の処理部MTC1における基板Wの一連の処理が完下すると、主搬送ロボットMTRは、次に 経成機特アームHAをこの第1の処理部MTC1に進入 させ、この第1の処理部MTC1における処理が終了し 50 た基板Wをハンド28の第二の保持部34に保持して撤出する。こうして、第1の処理部MTC2における処理対象の基板Wの搬入・搬出が行われる。

【0041】 この時、主搬送ロボットMTRは、図6 (b) に示すように、基板の中心線CR3がハンド28 の支持腕31、32の中心線CR1よりも阪中右側に変 位して基板Wを保持する。こうすることで、基板Wは、第二の保持部34を掲載する第一支持両35と第二支持 両41に配数することなく確認に保持される。

【0042】次に、主搬送ロボットMTRは、第1の処理部MTC1での洗浄処理が完了した洗浄済みよ板Wを ハンド28に保持した状態で、基板受け渡し位置まで勢動する。そして、インデクサ部1NDの近傍まで移動 し、インデクサロボット2のウエハ収容ハンドにその洗 浄済み基板やを受け渡す。

【0043】 ウエ・収容シンドに洗浄済み基保Wが受け 漉されたインデクサロボット2は、カセット製電部1に 載置された複数のカセットCのうちのいずれかのカセッ トCにその洗浄済み基保Wを収容する。この際、洗浄済 みの基板のみを収納するプンロードカセット上洗浄済み基板 Wが収納される。また、いわゆるユニカセットモードに おいては、その基板がが元々収納されてたカセットと の元表の収納位置に洗浄済み基板Wが収納されることになる。

【0044】以上のようにこの実施形態によれば、主搬 送口ボット州下 Rには、洗浄消剤基板の環境専用の保持部 と、洗浄済み基板の環出専用の保持部が、ハンド280 同面側に形成され偏えられている。これにより、未処理 の基板Wを保した履歴を持つ保持部によって、洗浄処理 が完了した洗浄済み基板Wが保持されることがなくな る。その結果、洗浄処理が完了した洗浄済み基板Wが再 汚染されることが附止される。

【0045】しかも、ハンド28は、複数の保持部3 3、34が同面側に設けられているので、簡単な構成で 現なる基板の保持が造成される。そして、基板の保持に 際して基板の一部が重なるように保持空間を設定するこ とで、ハンドの小型化が達成される。

【0046】 なお、上記第1 実施例において、本発明の 基板搬送装置を主搬送ロボットMTに適用する例を説 明したが、インデクサロボットとに適用してもよい。 【0047】以上、この発明の一実施形態について説明 したが、本発明は基板搬送装置を他の形態で実施するこ ともできる。

〈第2実施例〉図7は、第2実施例に係る基板搬送装置 が設けられる基板処理装置のレイアウトを示した簡略化 した平面図である。なお、第1実施例と同様の構成に関 しては、同符号を付与し説明を省略する。

【0048】カセット1Nは、未処理の基板Wを複数枚 積層収納するものであり、例えば、25枚の基板を収納 可能である。このカセットINは、カセット収置台に裁 質されている。また、カセットOUTは、それぞれ処理 済みの基板の体側取収前さる。この実施例処理では、高 清浄度に対応するためにカセットIN、OUTは密閉式 のFOUF構造を採用している。したかって、カセット 数置部1は、みカセットIN、OUTに配慮されている 図示しないシャッタを開閉する機構(図示省略)を備え ている。なお、前述のようにユニカセットモードに設定 できることは言うまでもない。

【0049】図中のカセット観響部1のX方向には、主 10 搬送ロボットMTR 2が尾備されている。この主輸送ロボットMTR 2は、未処理の基板Wを搬送し、処理済み の基板Wを搬送する1本のアームを備えている。主搬送 ロボットMTR 2は、ス種間りに旋門可能であり、かつ、ス軸に沿って昇降可能である。

【0050】主搬送ロボットMTR2を挟んでカセット 成階部1の反対側には、処理部Pが配設されている。こ の実施例装置では、例えば、処理部Pに第1の処理部M TC5と第2の処理部MTC6とを備えている。

【0052】第2実施例は、主搬送ロボットMTR2に おけるハンド280が第1実施例とは異なる。そして、 そのハンド280における保持部の配置に特徴があり、 以下、その構成に関して図7を参照して説明する。図8 はハンド280の形状を示す平面図である。

[0053] ハンド280は、搬送される基板Vの開縁 を保持するための第一の保持部330と第二の保持部3 40が、支持第310、320のそれぞれに配置される ことで第一の保持部330と第二の保持部340が2個 ずつ配置される。そして、その配置方向は、支持腕31 0、320の先端側とアームに連結される基端部側とに 離れて同一上前側に一体的に形成される。

【0054】 このような構成のハンド280によれば、 基板Wは、支持腕310、320の第一の保持部33 0、330による保持と、支持腕310、320の第二 の保持部340、340による保持が達成される。

【0055] そして、第一の保持部330、330によ 40 り基板Wが保持される時、基板Wの中心線CR20が支 持腕31、32の投手方向における保持部間の中心線C R10よりも関中左側に変位して基板Wを保持する。ま た、第二の保持第340、30により基板が保持さ れる時、基板Wの中心線CR30が支持腕31、32の 投手方向における保持が部間の中心線CR10よりも図中 右側に変位して基接が展付する。

【0056】つまり、第1実施例では基板Wが異なる保持部で保持される時に、その保持位置が支持腕31、3 2間でずれて保持される。一方、第2実施例は、基板W 50

10 が異なる保持部で保持される時に、その保持位置が支持 腕310、320の長手方向にずれて保持される点で異 たる。

【0057】その軽果、第1兆無例では、基底収を基板 施送装置MTR2で保持する時に、ハンド280の中断 方向に対して値交する方向に位置調整する必要があった が、この第2兆無例では、ハンド280の中略方向を制 動するだけで紙板や程以なる保持部330、340にそ れぞれ保持することができる。よって、主搬送ロボット MTR2のアームの仲略距離が設定されることで、異な る基板Wの保入が可能となる。

【0058】次に、上述した構成の主搬送ロボットMTR2の動作について図7を参照しながら説明する。以下の説明では、処理部Pのうち第1の処理部MTC5だけを使用するものとして説明する。

【0059】まず、未処理の基板WがカセットINから 主搬送ロボットMTR2によって第1の保持部330に 基板Wを保持することで取り出され、そのまま旋回して 第1の処理部MTC5へ搬入される。そして、基板Wに 対する処理が終了すると、主搬送ロボットMTR2が処 理済みの基板Wを預2の保持部340に最板Vを保持す ることで第1の処理部MTC5から取り出すとともに、 カセットOUTに搬送する。これで一枚の基板Wに対す る処理が完了する。

【0060】以上のように、この実施形態によれば、主 搬送ロボットMTR2には異なる基板保持部が、ハンド 280の同面側に形成され構えられている。これによ り、未処理の基板Wを保持した機歴を持つ保持部によっ て、洗浄処理が完了した洗浄浴み基板Wが保持されるこ とがなくなる。しかも、ハンド28は、簡単な構成で小 型化が達成される。

【0061】また、主搬送ロボットMTR2による基板 Wの搬入・搬出時に制御動作が従来のアームの仲稲田雄 の制御で行える。また、上記第2実施例によれば、四方 を保持部で保持しているので、その保持部の立ち上がり 地場合や、緊急的停止があった場合に、振波波直が述 い場合や、緊急的停止があった場合に、基板収が保持部 の支持面上を得ったとしても立ち上がり壁で規制され、 保持位置が大きくずれることをかにできる。

【0062】本発明は上述した実施例に限らず次のよう に変形実施することができる。

(1) 上記の実施形態においては、1本のハンドを行す 主搬送ロボットの例について説明したが、たとえば、 複数本のハンドが平面視において積層して配別された構 成のロボットを主搬送ロボットに代えて用いることもで きる。この場合に、3本ないし4本のハンドが全て平面 様において並列に配置されていてもよい。

【0063】(2)また、図9は、この発明の第3の実施形態に係るハンドの支持腕410、420を示す断面図である。上述の実施例に於いては各支持面35、3

7、38、40は平坦面に形成されていたが、この実施 例においては、支持腕410と支持腕420における第 一支持面430、450及び第二支持面440、460 は、支持される基板Wの中心側に向かって低くなるよう に不連続な傾斜面に形成されている。

【0064】 この場合、傾斜して保持される基板Wは、 両縁部が中心側に向かう力が発生するので、支持面上の 成滑力がが発生り難い。よって、基板Wの保持がより安 定した状態を維持できる。なお、この第3の実施例において、支持腕 410、420以外の部分については上述 10 の第1の実施例と同様であるので、図示および説明は省 略する。

【0065】 (3) また、図10は、この辞詞の第4の 炭施形態に係るハンドの支持腕510、520を示す断 面図である。実施例に於いては各支持面530、54 0、550、560は平坦面に保持される基板Wの下面 に当接する突起531、541、551、561を形成 されている。こうすることで、基板Wの保持時に基板W と接触する都位をより小さくすることで、基板Wへのゴ

ミの転移を軽減することができる。 【0066】(4)また、上巡の実施例では、支持面を それぞれの支持腕対して2面ずつ配置する構成とした が、3 前ずつ配置する特成としてもよい。すなわち、20 11に示すように3つも保持師600、610、620 を形成し、3 枚の基板を保持するようにしてもよい。こ の場合、第一の保持部600を洗浄前の基板Wの保持用 とし、第二の保持部610と第三の保持部620を洗浄 次二の保持部610と第三の保持部620を洗浄 次二の保持部610と第三の保持部620で洗浄 次二の保持部610と第三の保持部620で洗浄 次二の保持部610と第三の保持部620で洗浄 次二の保持部610と第三の保持部620で 大力で表示が表示となった。その結 果、洗浄処理が完了した洗浄済み基板Wが再符集される ことが防止される。

[0067] また、3面以上配置する構成としてもよい が、保持部がそれだけ上方に高くなり、基板を保持する 時の何終が大きくなる。よって、2面乃至3面を配置す る構成が実用上、好適と言える。

【0068】(5)また、上記の実施形態では、基板を 処理するための基板処理装置を例にとって説明したが、 この発明は、液温表示後護用ガラス基板などの他の種類 の被処理基板に対して処理を施す装置にも適用可能である。 る。その他、特許請求の範囲に記載された技術的事項の 範囲で離々の(設計)変更を施すことが可能である。 【0069】なお、本明細帯において「洗浄」とは、基 板方面の不必要が、たたるは、パーティクル、体鞭物。

【0069】なお、本中期書において「洗浄」とは、基 板表前の不実験(たとえば、バーティクル、有機物、金 属イオン、前処理での装落やガス等)や薄膜(たとえ ば、金順順、酸化限、能線服等)を除去する処理のこと を粘し、たとえば、基核表面にフッ酸をどの強やその ベーバーを供給して、基板表面の薄膜をエッチングする いわゆるエッチング処理をも含む。滴、本実施例の数を アームのハンドはフォーク形状なので、露光類域のみを 50

薄膜 (ペリクル) で覆ったマスクでも同様に搬送できる。

[0070]

【発明の効果】以上の如く本窓明によれば、ハンドの同 面側で複数の基極を保持できるコンパクトな基板搬送装 臓が提供される。それゆえ、例えば、未洗浄の基板を保 持した履歴を持つハンドの保持部で洗浄済み基板が保持 されることがないので、ハンドの保持部からのパーティ クルによって洗浄済み基板が再汚染されることはない基 板搬送装置が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の基板搬送装置が設けられる基板処理 装置のレイアウトを示す簡略化した平面図である。

【図2】主搬送ロボットMTRの構成例を示す簡略化した斜視図である。

【図3】主搬送ボットMTRの平面図である。

【図4】主搬送ボットMTRの側面図である。

【図5】支持腕31、32の形状を示す平面図である。 【図6】図6 は、図5のAA-AA線で切断した部部

断面で、図6(a)は、支持腕31、32が洗浄前の基板Wを支持した状態を、図6(b)は、支持腕31、32が洗浄後の基板Wを支持した状態を示す説明図であった。

【図7】第2の実施例に係る基板搬送装置が設けられる 基板処理装置のレイアウトを示す簡略化した平面図であ

【図8】第2の実施例に係るハンドの構成例を示す平面 図である。 【図9】第3の実施形態に係るハンドの支持腕を示す断

面図である。 【図10】第4の実施形態に係るハンドの支持腕を示す 断面図である。

【図11】さらに他の実施形態に係る説明図である。

【符号の説明】 W 基板

MTR、MTR2 主搬送ロボット

HA 基板保持アーム

28. 280 ハンド

31、32、310、320、410、420、51 60 0、520 支持腕

33、600 第一の保持部

33、600 第二の保持部

630 第三の保持部

35、38、430、450 第一支持面 36、39 立ち上がり壁

37、40、440、460 第二支持面 C カセット

2 インデグサロボット

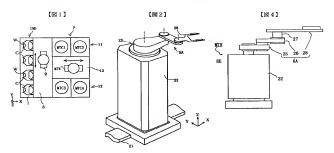
22 基台

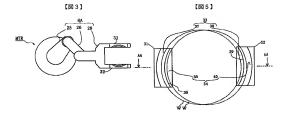
23 昇降・回転台

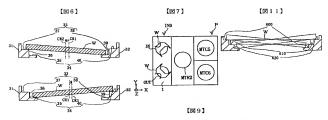
13

25 第1のアーム

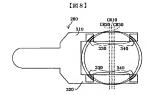
26 第2のアーム

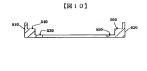












フロントページの続き

(51) Int.C1.7

識別記号

648

F I H O 1 L 21/304 テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/304 (72)発明者 古村 智之

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株

式会社内

Fターム(参考) 3B116 AAO2 AAO3 ABO8 AB23 BBOO

CC03

3C007 AS05 AS24 BS15 CT02 CT04

648A

CTO5 CVO7 CWO7 DSO1 ES17 EVO5 EV24 EW16 NSO9 NS12

NS13 5F031 CAO2 CAO5 FAO1 FAO2 FA18 GAO5 GAO6 GA43 MA23 PA26